

⑫ 公開実用新案公報(U) 平1-145140

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>

H 01 L 23/50  
23/52

識別記号

庁内整理番号

W-7735-5F  
C-7454-5F

⑭ 公開 平成1年(1989)10月5日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 考案の名称 集積回路用パッケージ

⑯ 実 願 昭63-41423

⑰ 出 願 昭63(1988)3月28日

⑱ 考 案 者 笹 田 達 義 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内

⑲ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑳ 代 理 人 弁理士 大 岩 増 雄 外2名

㉑ 実用新案登録請求の範囲

ダイパッド上に接着材料により接着されたチップと、前記チップ内のボンディングパッドとリードフレームのめつき部分をワイヤにより接続され、前記チップ、ダイパッド、ワイヤとリードフレームの一部を封止材料により封止されたパッケージにおいて、リードフレームを段違いに配置したことを特徴とする集積回路用パッケージ。

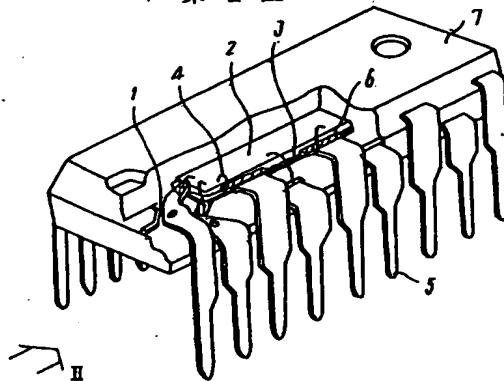
図面の簡単な説明

第1図はこの考案の一実施例による集積回路用パッケージを示す部分断面斜視図、第2図は第1

図の矢印IIにおける側面断面図、第3図第5図はこの考案の他の実施例を示す部分断面斜視図、第4図、第6図はそれぞれ第3図と第5図の矢印IVおよびVIにおける側断面図、第7図は従来の集積回路用パッケージの部分断面斜視図、第8図は第7図の矢印VIIIにおける側断面図である。

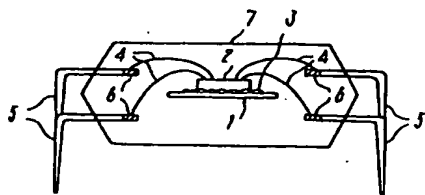
図において、1はダイパッド、2はチップ、3は接着材料、4はワイヤ、5はリードフレーム、6はめつき部分、7は封止材料を示す。なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。

第 1 図

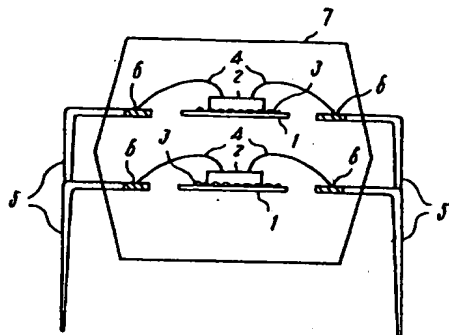


- 1: ダイパッド
- 2: チップ
- 3: 接着材料
- 4: ワイヤ
- 5: リードフレーム
- 6: めつき部分
- 7: 封止材料

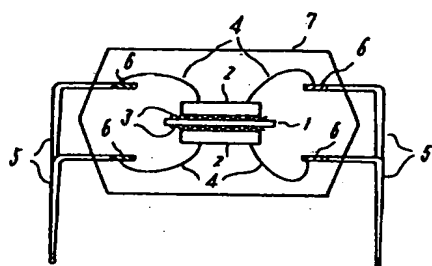
第 2 図



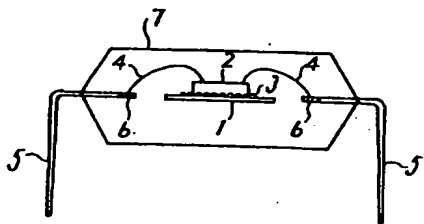
第 4 図



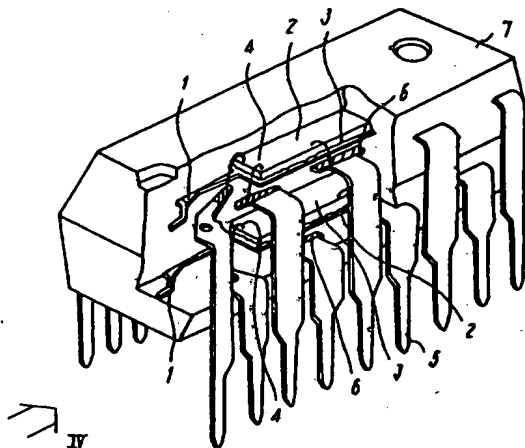
第 6 図



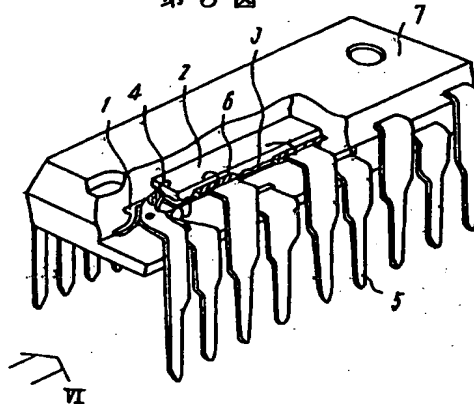
第 8 図



第 3 図



第 5 図



第 7 図

